



CBTech[®]

川寶科技股份有限公司
CHIME BALL TECHNOLOGY CO. LTD.

創新

Create

卓越

Best

科技

Technology

法人說明會

股票代碼: 1595

Presented by : 川寶科技董事長 張鴻明
執行長 呂理宏

2024年05月27日

本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他本公司無法掌控之風險等因素。本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。

議 程

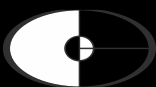
集團介紹

財務報告

未來展望

Q&A

集團介紹



川寶集團

股票代碼: 1595



集團願景

CBT GROUP VISION

成為最佳的 IT 生態產業製造解決方案提供者。

To Become The Best of IT Fabrication

ECOSystem Solution Provider

川寶集團成員暨重要關係企業

川寶科技 (CBT)

Chime Ball Technology Co., Ltd.

PCB 軟硬板曝光機/軟板RTR曝光機

PCB 軟硬板線路LDI/防焊DI 直接成像曝光機
研發製造

寶虹科技 (BHT)

Bao Hong Semi Tech Co., Ltd.

半導體晶圓製造設備,軟體服務,零件供應商

川康國際貿易 (上海)

CK International (SH) Co., Ltd.

川寶/寶虹 大陸地區零件維修售服貿易公司

寶驊科技

Bao Hua Technology Co., Ltd.

半導體AOI 影像檢查機

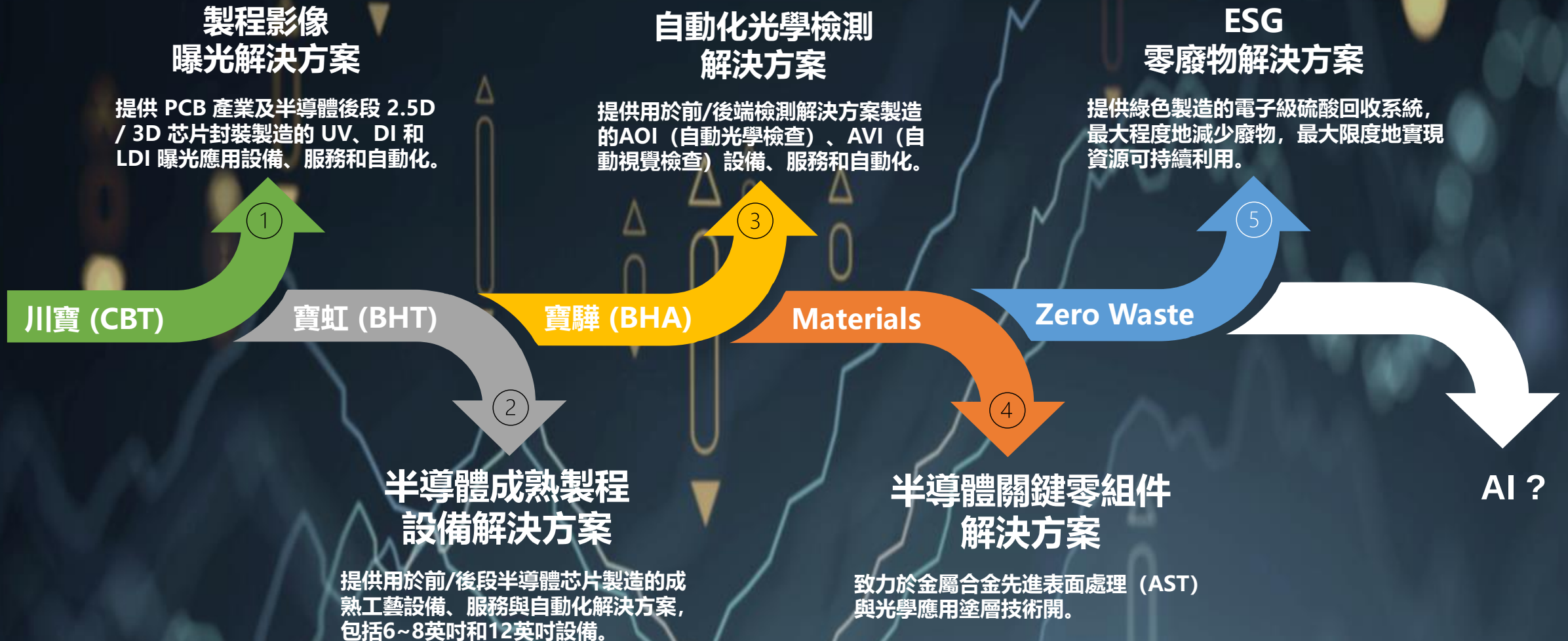
軟體開發服務

抱樸科技

Pure Metallica Co., Ltd.

半導體 PEALD 薄膜製造設備服務

川寶集團 - 提供 IT 製造 所需設備解決方案的提供者



集團總部與子公司及服務據點所在地分布圖

川寶集團全球分布

為滿足PCB/半導體產業需求川寶集團在全球建立優質服務銷網路，目前已建立5個據點區

- ✓ 台灣
- ✓ 中國
- ✓ 韓國
- ✓ 泰國
- ✓ 美國

北美研發&服務辦公室
Santa Clara, CA

泰國辦事處
Bangkok, Thailand

中國華南分公司
Dongguan, China

中國華東分公司
Kunshan, China

川寶集團總部
Taoyuan City, Taiwan
川寶研發中心 / 寶虹科技
Hsinchu City, Taiwan



財務報告

2021~2024 Q1合併營收、毛利率、 淨利率、EPS及現金股利殖利率

單位:新台幣仟元

	2021	2022	2023	2024'Q1
合併營收	2,417,036	1,795,723	1,407,762	207,120
毛利率	25%	27%	27%	33%
淨利率	8%	13%	3%	8%
EPS	3.93	4.85	1.04	0.36
現金殖利率	1.38%	5.43%	5.01%	
每股淨值	53.65	56.50	55.34	54.77

2023 Q1和2024 Q1的合併綜合損益表

科目	2023 Q1	%	2024 Q1	%	YoY
營業收入	318,555	100%	207,120	100%	-35%
營業毛利	100,478	32%	68,877	33%	-31%
營業費用	(78,222)	-25%	(74,631)	-36%	-5%
營業淨利	22,256	7%	(5,754)	-3%	-126%
營業外收支	(2,738)	-1%	32,266	16%	1278%
稅前淨利	19,518	6%	26,512	13%	36%
所得稅費用	(7,687)	-2%	(9,569)	-5%	24%
稅後淨利	11,831	4%	16,943	8%	43%
每股盈餘 (元)	0.27		0.36		33%

單位:新台幣仟元

合併資產負債表

科目	2023 Q1	%	2023 Q4	%	2024 Q1	%
現金及約當現金	1,330,843	27%	988,138	23%	798,721	18%
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	30,450	1%	120,105	3%	217,400	5%
應收款項	419,470	8%	319,565	7%	361,821	8%
存貨	1,808,189	36%	1,474,410	34%	1,445,462	33%
其他流動資產	145,627	3%	102,590	2%	98,520	2%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	-	0%	2,090	0%	2,090	0%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	80,405	2%	76,796	2%	76,867	2%
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	29,104	1%	29,779	1%	91,035	2%
不動產、廠房及設備	794,806	16%	847,762	19%	858,674	20%
使用權資產	16,175	0%	17,347	0%	15,890	0%
商譽	213,440	4%	213,440	5%	213,440	5%
無形資產	122,041	2%	97,381	2%	90,414	2%
其他非流動資產	7,511	0%	92,688	2%	72,811	2%
資產總計	4,998,061	100%	4,382,091	100%	4,343,145	100%

單位:新台幣仟元

合併資產負債表

科目	2023 Q1	%	2023 Q4	%	2024 Q1	%
流動負債	2,139,959	43%	1,372,763	31%	1,389,433	32%
非流動負債	257,228	5%	361,242	8%	328,590	8%
負債總計	2,397,187	48%	1,734,005	40%	1,718,023	40%
普通股股本	474,226	9%	477,861	11%	478,754	11%
資本公積	567,379	11%	575,534	13%	577,432	13%
保留盈餘	1,552,004	31%	1,588,633	36%	1,558,091	36%
其他權益	4,205	0%	2,653	0%	7,741	0%
非控制權益	3,060	0%	3,405	0%	3,104	0%
權益總計	2,600,874	52%	2,648,086	60%	2,625,122	60%

單位:新台幣仟元

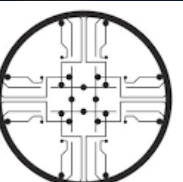
未來展望

川寶集團未來五年戰略聚焦



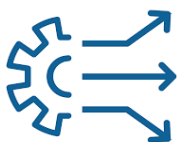
印刷電路板產業

佈局先進載板市場，開發載板LDI/Stepper曝光設備及相關AVI 自動視覺檢查設備產品，封裝用曝光設備開發。



半導體製程設備產業

前段再生成熟製程12" CVD 設備開發，TGV Sputer濺鍍設備開發，IC老化爐代理銷售服務業務。



半導體關鍵零組件

先進製程關鍵零組件鍍膜零件業務。



RECYCLE

半導體電子級硫酸回收業務

先進製程半導體電子級硫酸回收設備銷售業務。



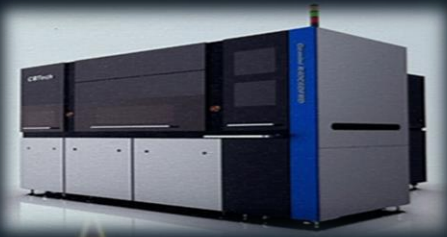
1. 印刷電路板產業

2027

2026

2025

Now



Ares S3 (Stepper)

Gemini R50D/R35D/R25D/R8D

Gemini CSM50D / TiTAN CSM50
Gemini CSM25D / TiTAN CSM25

SEMI X10

Gemini 8600SR_F

TiTAN 8000PSR_H

Raptor 7000

TiTAN 9000

TiTAN 8000

UV LED

405nm Laser

Hybrid UV
LED+ Laser

Triple
wavelength
UV LED

ABF

CSP
BGA
PCB
FPC
HLC
HDI

MEMS

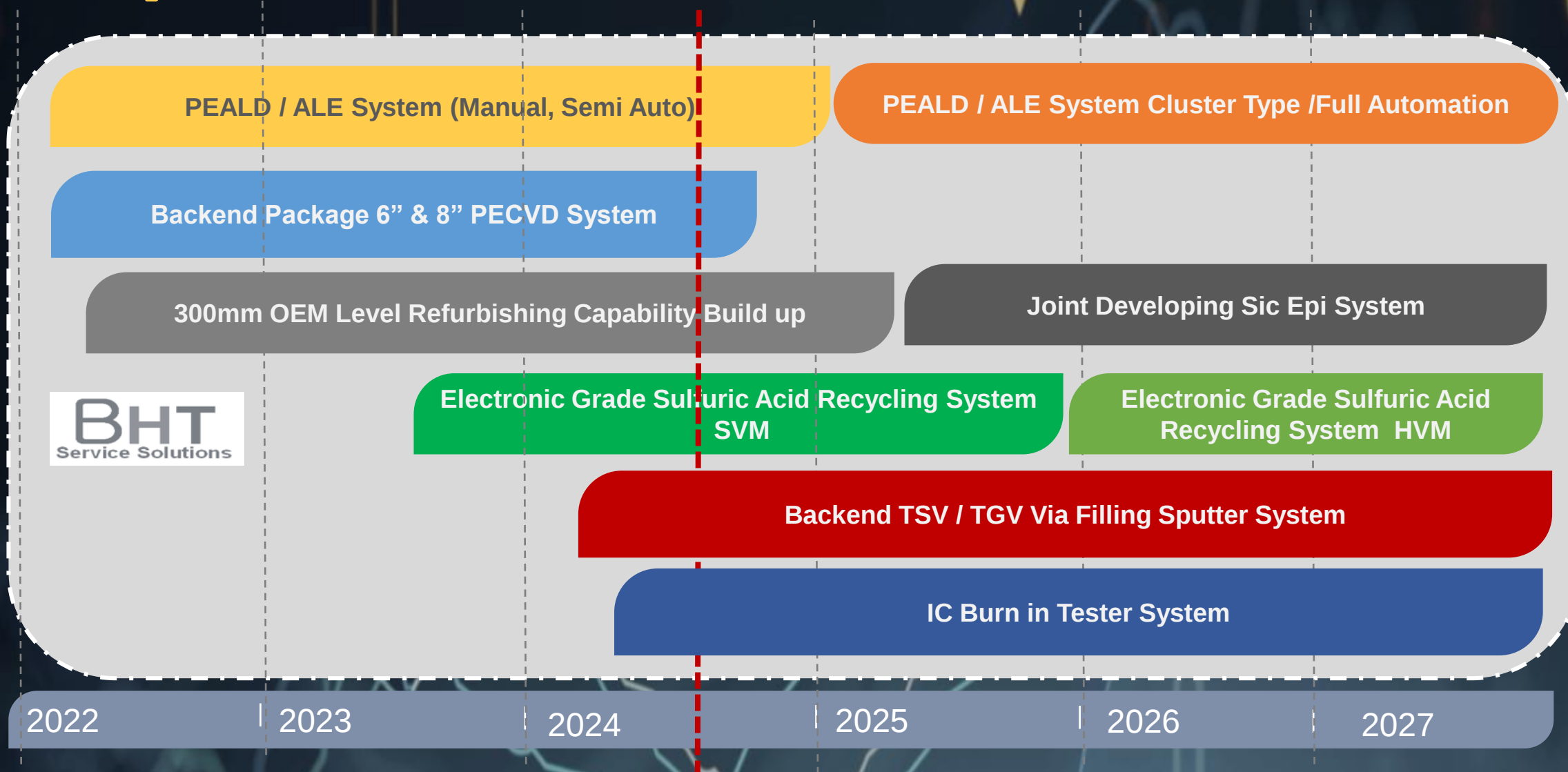
PCB
FPC
HLC

Time

Model

Light Source Application

2. 半導體製程產業





川寶東南亞佈局

效益評估

- 泰國市場
- 東協RCEP 關稅協定
- 前進印度市場

中國
印度
新加坡
馬來西亞

泰國分公司

- Cbt Converge Thailand
Rojana I.P - Ayutthaya
- Service Point: 108/230-231 Supalai Palm Spring
Rama2 Village, Moo.7, Khok Kham, Muang
Samutsakorn, Samutsakorn 74000

設廠地點

Rojana I.P - Ayutthaya			
Plot	rai	SQM	坪
57.1	2.5	4,000	1210
57.2	7.3	11,680	3533.2
	9.8	15,680	4,743

2024/4/E 已取得泰國BOI 投資優惠 A1 資格核准



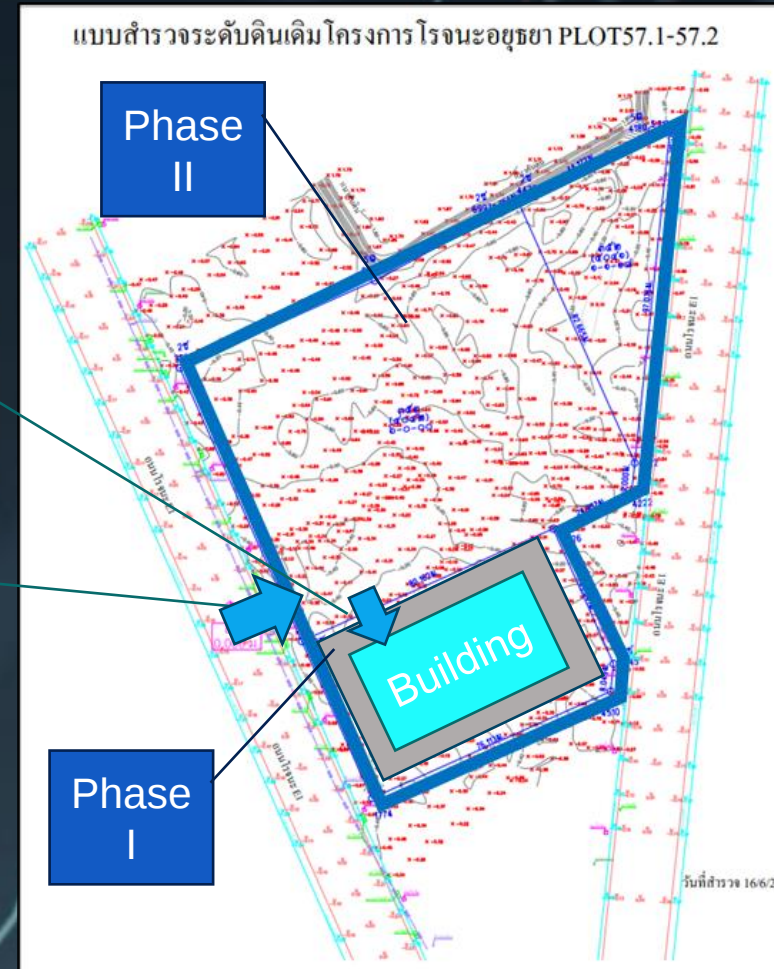
Building Scale and Dimensions Phase I

第一期建築規模和尺寸

1. Total Space of phase I building: 4000SQM
2. Number of Floor: 1 floor
3. Height Limitation: N/A

Lobby
Office
Entrance

Main Gate of
Campus



川寶泰國建廠計劃 CBT Converge Thailand



◆ 12 months for construction, architecture design and license application are not included.

Q & A

創新
Create

卓越
Best

科技
Technology